

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二三年第三季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2023年11月9日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二三年九月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二三年第三季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入 5.685 亿美元，同比下降 9.7%，环比下降 10.0%。
- 毛利率 16.1%，同比下降 21.1 个百分点，环比下降 11.6 个百分点。
- 母公司拥有人应占溢利 1,390 万美元，上年同期为 1.039 亿美元，上季度为 7,850 万美元。
- 基本每股盈利 0.009 美元，上年同期为 0.080 美元，上季度为 0.060 美元。
- 净资产收益率（年化）1.2%，上年同期为 14.4%，上季度为 10.0%。

二零二三年第四季度指引

- 我们预计销售收入约在 4.5 亿美元至 5.0 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 2% 至 5% 之间。

总裁致辞

公司总裁兼执行董事唐均君先生对二零二三年第三季度业绩评论道：

“当前宏观环境复杂多变，半导体行情尚未复苏。华虹半导体在艰巨挑战中砥砺前行，于二零二三年第三季度实现了 5.685 亿美元营收，当季毛利率为 16.1%，符合指引预期。随着华虹无锡 12 英寸生产线项目产能爬坡，截至第三季度末，公司折合八英寸月产能增加到了 35.8 万片。在具备了更大规模生产能力的同时，也为新产品的研发上线提供了更强劲的支持。凭借多年来在特色工艺领域的技术积累和多元化工艺平台优势，公司的各项产品，尤其是 IGBT 和超级结，在新能源、汽车电子等领域持续发力，获得了客户的高度认可。”

唐总继续讲道：“公司的第二条 12 英寸生产线--华虹无锡制造项目，正在紧锣密鼓地推进中。目前，该项目处于厂房建设阶段，预计将于 2024 年底前建成投产，并在随后的三年内逐步形成 8.3 万片的月产能，为公司的中长期发展打下坚实基础。即使市场低迷，公司依然注重研发投入和团队建设，持续提高产品质量和各项性能指标，进一步夯实特色工艺晶圆代工龙头地位，以更出色的业绩回馈投资人。”

电话会议公告

- 日期 2023 年 11 月 9 日（星期四）
- 时间： 17:00 香港/上海时间
04:00 美国东部时间
- 发言人： 唐均君，总裁兼执行董事
王鼎，执行副总裁兼首席财务官
- 广播： 会议将在 http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/a6md2c9y> 作线上直播
(请提前注册登记)
- 电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN（个人身份识别码）。

<https://register.vevent.com/register/Blcd83b51831f1463db11bdea840a69615>

重要提示： 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN（个人身份识别码）才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN（个人身份识别码）。
- 网上重播： 直播约 12 小时后，您可于 12 个月内在以下网页重复收听会议。

http://www.huahonggrace.com/c/investor_webcast.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司（A 股简称：华虹公司，688347；港股简称：华虹半导体，01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等“8 英寸 + 12 英寸”特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂（华虹一厂、二厂及三厂），月产能约 18 万片。另在无锡高新技术产业开发区内建有一座月产能 8.0 万片的 12 英寸晶圆厂（华虹七厂），这不仅是全球领先的 12 英寸特色工艺生产线，也是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。目前，本公司正在推进华虹无锡二期 12 英寸芯片生产线（华虹九厂）的建设。

如欲取得更多公司相关资料，请浏览：www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	568,529	629,907	631,381	(9.7)%	(10.0)%
毛利	91,623	234,056	175,056	(60.9)%	(47.7)%
毛利率	16.1%	37.2 %	27.7 %	(21.1)	(11.6)
经营开支	(85,065)	(73,611)	(76,668)	15.6 %	11.0 %
其他损失净额	(19,417)	(57,825)	(54,709)	(66.4)%	(64.5)%
税前(损失)/溢利	(12,859)	102,620	43,679	(112.5)%	(129.4)%
所得税开支	(12,999)	(37,174)	(35,845)	(65.0)%	(63.7)%
期内(损失)/溢利	(25,858)	65,446	7,834	(139.5)%	(430.1)%
净利润率	(4.5)%	10.4 %	1.2 %	(14.9)	(5.7)
以下各方应占利润:					
母公司拥有人	13,890	103,899	78,524	(86.6)%	(82.3)%
非控股权益	(39,748)	(38,453)	(70,690)	3.4 %	(43.8)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.009	0.080	0.060	(88.8)%	(85.0)%
摊薄	0.009	0.079	0.060	(88.6)%	(85.0)%
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,077	1,003	1,074	7.4 %	0.3 %
产能利用率 ¹	86.8 %	110.8 %	102.7 %	(24.0)	(15.9)
净资产收益率 ²	1.2 %	14.4 %	10.0 %	(13.2)	(8.8)

二零二三年第三季度

- 销售收入 5.685 亿美元, 同比下降 9.7%, 环比下降 10.0%, 主要由于平均销售价格下降。
- 毛利率 16.1%, 同比下降 21.1 个百分点, 环比下降 11.6 个百分点, 主要由于平均销售价格下降及产能利用率降低。
- 经营开支 8,510 万美元, 同比上升 15.6%, 环比上升 11.0%, 主要由于工程片开支增加。
- 其他损失净额 1,940 万美元, 同比下降 66.4%, 环比下降 64.5%, 主要由于外币汇兑损失下降, 部分被政府补贴减少所抵消。
- 所得税开支 1,300 万美元, 同比下降 65.0%, 环比下降 63.7%, 主要由于应课税利润下降。
- 期内损失 2,590 万美元, 上年同期为期内溢利 6,540 万美元, 上季度为期内溢利 780 万美元。
- 母公司拥有人应占溢利 1,390 万美元, 上年同期为 1.039 亿美元, 上季度为 7,850 万美元。
- 基本每股盈利 0.009 美元, 上年同期为 0.080 美元, 上季度为 0.060 美元。
- 净资产收益率 (年化) 1.2%, 上年同期为 14.4%, 上季度为 10.0%。

¹ 产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

² 母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	538,547	94.7 %	598,553	95.0 %	(60,006)	(10.0)%
其他	29,982	5.3 %	31,354	5.0 %	(1,372)	(4.4)%
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度 94.7% 的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	298,615	52.5 %	384,235	61.0 %	(85,620)	(22.3)%
12 吋晶圆	269,914	47.5 %	245,672	39.0 %	24,242	9.9 %
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.986 亿美元及 2.699 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	441,246	77.5 %	452,306	71.8 %	(11,060)	(2.4)%
北美 ⁴	48,764	8.6 %	80,450	12.8 %	(31,686)	(39.4)%
欧洲	38,976	6.9 %	30,340	4.8 %	8,636	28.5 %
亚洲 ⁵	34,663	6.1 %	55,733	8.8 %	(21,070)	(37.8)%
日本 ⁶	4,880	0.9 %	11,078	1.8 %	(6,198)	(55.9)%
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度来自于中国的销售收入 4.412 亿美元，占销售收入总额的 77.5%，同比下降 2.4%，主要由于 MCU、智能卡芯片和其他电源管理产品需求减少，部分被 IGBT、模拟及超级结产品需求增加所抵消。
- 本季度来自于北美的销售收入 4,880 万美元，同比下降 39.4%，主要由于其他电源管理及 MCU 产品的需求减少。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 3,900 万美元，同比增长 28.5%，主要得益于 IGBT 和智能卡芯片的需求增加。
- 本季度来自于亚洲的销售收入 3,470 万美元，同比下降 37.8%，主要由于 MCU 及逻辑产品的需求减少。
- 本季度来自于日本的销售收入 490 万美元，同比下降 55.9%，主要由于 MCU 产品的需求减少。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	143,629	25.3 %	213,813	33.9 %	(70,184)	(32.8)%
独立式非易失性存储器	36,800	6.5 %	43,473	6.9 %	(6,673)	(15.3)%
分立器件	235,978	41.5 %	191,391	30.4 %	44,587	23.3 %
逻辑及射频	49,878	8.8 %	59,069	9.4 %	(9,191)	(15.6)%
模拟与电源管理	100,897	17.7 %	121,777	19.3 %	(20,880)	(17.1)%
其他	1,347	0.2 %	384	0.1 %	963	250.8 %
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.436 亿美元，同比下降 32.8%，主要由于 MCU 及智能卡芯片的需求减少。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 3,680 万美元，同比下降 15.3%，主要由于 NOR flash 产品的需求减少。
- 本季度分立器件销售收入 2.360 亿美元，同比增长 23.3%，主要得益于 IGBT 及超级结产品的需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 4,990 万美元，同比下降 15.6%，主要由于逻辑产品的需求减少。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.009 亿美元，同比下降 17.1%，主要由于其他电源管理产品的需求减少。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
55nm 及 65nm	87,329	15.4 %	78,566	12.5 %	8,763	11.2 %
90nm 及 95nm	87,616	15.4 %	141,726	22.5 %	(54,110)	(38.2)%
0.11 μ m 及 0.13 μ m	82,990	14.6 %	113,063	17.9 %	(30,073)	(26.6)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	34,993	6.2 %	54,590	8.7 %	(19,597)	(35.9)%
0.25 μ m	8,395	1.5 %	3,471	0.6 %	4,924	141.9 %
0.35 μ m 及以上	267,206	46.9 %	238,491	37.8 %	28,715	12.0 %
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度 55nm 及 65nm 工艺技术节点的销售收入 8,730 万美元，同比增长 11.2%，主要得益于模拟及其他电源管理产品需求增加，部分被逻辑及 NOR flash 产品的需求减少所抵消。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 8,760 万美元，同比下降 38.2%，主要由于其他电源管理、智能卡芯片及 MCU 产品的需求减少。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工艺技术节点的销售收入 8,300 万美元，同比下降 26.6%，主要由于 MCU 产品的需求减少。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工艺技术节点的销售收入 3,500 万美元，同比下降 35.9%，主要由于 MCU 及逻辑产品的需求减少。
- 本季度 0.25 μ m 工艺技术节点的销售收入 840 万美元，同比上升 141.9%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工艺技术节点的销售收入 2.672 亿美元，同比增长 12.0%，主要得益于 IGBT 及超级结产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二三年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二三年 第三季度 % (未经审核)	二零二二年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二二年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
电子消费品	325,224	57.2 %	408,328	64.9 %	(83,104)	(20.4)%
工业及汽车	159,380	28.0 %	148,889	23.6 %	10,491	7.0 %
通讯	71,662	12.6 %	54,138	8.6 %	17,524	32.4 %
计算器	12,263	2.2 %	18,552	2.9 %	(6,289)	(33.9)%
销售收入总额	568,529	100.0 %	629,907	100.0 %	(61,378)	(9.7)%

- 本季度电子消费品作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 3.252 亿美元，占销售收入总额的 57.2%，同比下降 20.4%，主要由于 MCU、其他电源管理及智能卡芯片的需求减少，部分被超级结产品的需求增加所抵消。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.594 亿美元，同比增长 7.0%，主要得益于 IGBT 产品需求增加，部分被 MCU 及智能卡芯片需求减少所抵消。
- 本季度通讯产品销售收入 7,170 万美元，同比增长 32.4%，主要得益于模拟产品需求增加。
- 本季度计算器产品销售收入 1,230 万美元，同比下降 33.9%，主要由于通用 MOSFET 及 MCU 产品需求减少。

产能⁷及产能利用率

晶圆厂(折合 8 吋千片晶圆)	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)
产能 (200mm)	178	178	178
产能 (300mm)	80	65	75
合计产能	358	324	347
产能利用率 (200mm)	95.3%	113.4%	112.0%
产能利用率 (300mm)	78.4%	107.7%	92.9%
总体产能利用率	86.8%	110.8%	102.7%

- 本季度末月产能 358,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 86.8%。

⁷ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,077	1,003	1,074	7.4 %	0.3 %

■ 本季度付运晶圆 1,077,000 片，同比上升 7.4%，环比持平。

经营开支分析

以千美元计	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,415	2,524	2,402	(4.3)%	0.5 %
管理费用 ⁸	82,650	71,087	74,266	16.3 %	11.3 %
经营开支	85,065	73,611	76,668	15.6 %	11.0 %

■ 经营开支 8,510 万美元，同比上升 15.6%，环比上升 11.0%，主要由于工程片开支增加。

其他损失净额

以千美元计	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,428	3,372	3,921	1.7 %	(12.6)%
利息收入	15,742	7,054	14,057	123.2 %	12.0 %
汇兑损失	(13,986)	(79,444)	(62,646)	(82.4)%	(77.7)%
分占联营公司(损失)/溢利	(1,410)	2,561	1,984	(155.1)%	(171.1)%
财务费用	(24,257)	(16,886)	(28,287)	43.7 %	(14.2)%
政府补贴	77	24,663	14,213	(99.7)%	(99.5)%
其他	989	855	2,049	15.7 %	(51.7)%
其他损失净额	(19,417)	(57,825)	(54,709)	(66.4)%	(64.5)%

■ 其他损失净额 1,940 万美元，同比下降 66.4%，环比下降 64.5%，主要由于外币汇兑损失下降，部分被政府补贴减少所抵消。

⁸ 管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二二年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	152,091	158,604	161,190	(4.1)%	(5.6)%
投资活动所用现金流量净额	(177,466)	(399,962)	(150,649)	(55.6)%	17.8 %
融资活动所得/(用)现金流量净额	3,176,383	579,684	(300,183)	448.0 %	(1,158.1)%
外汇汇率变动影响净额	(12,464)	(61,748)	(77,948)	(79.8)%	(84.0)%
现金及现金等价物变动影响净额	3,138,544	276,578	(367,590)	1,034.8 %	(953.8)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 1.521 亿美元，同比下降 4.1%，主要由于政府补贴减少，部分被支付的贷款减少所抵消，环比下降 5.6%，主要由于政府补贴减少及人员开支增加，部分被支付所得税减少所抵消。
- 投资活动所用现金流量净额 1.775 亿美元，其中包括固定资产及无形资产投资支出 1.937 亿美元，部分被收到利息收入 1,620 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 31.764 亿美元，其中包括 A 股科创板发行股份募集资金 29.370 亿美元，提取银行借款 3.477 亿美元，质押保证金减少 1.365 亿美元，员工行权发行股份收到 70 万美元，部分被偿还银行借款 2.391 亿美元，支付利息 380 万美元，支付上市费用 140 万美元及支付租赁负债 120 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)
资产总额	9,974,339	6,950,336
负债总额	2,642,094	2,555,160
所有者权益总额	7,332,245	4,395,176
资产负债率 ⁹	26.5%	36.8%

资本开支

以千美元计	二零二三年 第三季度 (未经审核)	二零二三年 第二季度 (未经审核)
华虹 8 吋	22,795	16,677
华虹无锡	111,827	148,289
华虹制造	59,030	-
合计	193,652	164,966

- 本季度资本开支 1.937 亿美元，其中 1.118 亿美元用于华虹无锡，5,900 万美元用于华虹制造。

⁹ 资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)
发展中物业	157,230	143,674
存货	492,783	558,252
贸易应收款项及应收票据	318,787	310,705
预付款项、其他应收款项及其他资产	34,168	32,194
应收关联方款项	19,572	16,803
已冻结存款及定期存款	31,654	167,077
现金及现金等价物	4,989,501	1,850,957
流动资产总额	6,043,695	3,079,662
贸易应付款项	213,530	227,907
其他应付款项及暂估费用	357,181	397,826
计息银行借款	180,238	385,746
租赁负债	3,281	4,477
政府补助	34,321	34,133
应付关联方款项	4,604	4,720
应付所得税	57,885	49,557
流动负债总额	851,040	1,104,366
净营运资金	5,192,655	1,975,296
速动比率	6.3x	2.2x
流动比率	7.1x	2.8x
贸易应收款项及应收票据周转天数	50	45
存货周转天数	99	114

- 存货由上季度末的 5.583 亿美元下降至本季度末的 4.928 亿美元，主要由于产成品及在制品的减少。
- 已冻结存款及定期存款由上季度末的 1.671 亿美元下降至本季度末的 3,170 万美元，主要由于银行借款质押保证金减少。
- 现金及现金等价物由上季度末的 18.510 亿美元上升至本季度末的 49.895 亿美元，主要由于前述现金使用分析中阐述的原因。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 3.978 亿美元下降至本季度末的 3.572 亿美元，主要由于应付资产开支减少。
- 计息银行借款由上季度末的 3.857 亿美元下降至本季度末的 1.802 亿美元，主要由于偿还银行借款本金。
- 净营运资金 本季度末 51.927 亿美元，流动比率 7.1。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 50 天。
- 存货周转天数 99 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
 简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二二年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)
销售收入	568,529	629,907	631,381
销售成本	(476,906)	(395,851)	(456,325)
毛利	91,623	234,056	175,056
其他收入及收益	20,290	35,967	34,245
销售及分销费用	(2,415)	(2,524)	(2,402)
管理费用	(82,650)	(71,087)	(74,266)
其他费用	(14,040)	(79,467)	(62,651)
财务费用	(24,257)	(16,886)	(28,287)
分占联营公司(损失)/溢利	(1,410)	2,561	1,984
税前(损失)/溢利	(12,859)	102,620	43,679
所得税开支	(12,999)	(37,174)	(35,845)
期内(损失)/溢利	(25,858)	65,446	7,834
以下各方应占利润			
母公司拥有人	13,890	103,899	78,524
非控股权益	(39,748)	(38,453)	(70,690)
持有人应占每股盈利			
基本	0.009	0.080	0.060
摊薄	0.009	0.079	0.060
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,580,159,540	1,303,756,848	1,308,028,146
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,587,083,357	1,311,796,050	1,318,619,081

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二二年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	3,322,946	3,256,562	3,140,178
投资物业	164,287	163,241	165,746
使用权资产	79,070	80,145	78,359
无形资产	29,182	31,170	34,447
于联营公司的投资	128,833	129,414	116,894
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	153,024	151,812	163,182
长期预付款项	36,085	40,937	21,939
递延税项资产	17,217	17,393	15,157
非流动资产总额	3,930,644	3,870,674	3,735,902
流动资产			
发展中物业	157,230	143,674	117,971
存货	492,783	558,252	509,630
贸易应收款项及应收票据	318,787	310,705	240,551
预付款项、其他应收款项及其他资产	34,168	32,194	60,304
应收关联方款项	19,572	16,803	10,764
已冻结存款及定期存款	31,654	167,077	1,022
现金及现金等价物	4,989,501	1,850,957	1,984,228
流动资产总额	6,043,695	3,079,662	2,924,470
流动负债			
贸易应付款项	213,530	227,907	223,704
其他应付款项及暂估费用	357,181	397,826	621,494
计息银行借款	180,238	385,746	422,913
租赁负债	3,281	4,477	4,564
政府补助	34,321	34,133	63,274
应付关联方款项	4,604	4,720	10,265
应付所得税	57,885	49,557	57,730
流动负债总额	851,040	1,104,366	1,403,944
流动资产净额	5,192,655	1,975,296	1,520,526
总资产减流动负债	9,123,299	5,845,970	5,256,428
非流动负债			
计息银行借款	1,745,779	1,410,544	1,355,037
租赁负债	18,650	18,312	14,976
递延税项负债	26,625	21,938	26,827
非流动负债总额	1,791,054	1,450,794	1,396,840
净资产	7,332,245	4,395,176	3,859,588
权益和负债权益			
股本	4,932,673	1,997,829	1,993,604
储备	1,164,151	1,130,367	808,552
本公司拥有人应占权益	6,096,824	3,128,196	2,802,156
非控股权益	1,235,421	1,266,980	1,057,432
权益总额	7,332,245	4,395,176	3,859,588

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二三年 (未经审核)	于九月三十日 二零二二年 (未经审核)	于六月三十日 二零二三年 (未经审核)
经营活动所得现金流量:			
税前(亏损)/溢利	(12,859)	102,620	43,679
折旧及摊销	127,305	116,426	123,661
应占联营公司亏损/(溢利)	1,410	(2,561)	(1,984)
营运资金的变动及其它	36,235	(57,881)	(4,166)
经营活动所得现金流量净额	152,091	158,604	161,190
投资活动所用现金流量:			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(193,652)	(428,684)	(164,966)
其他投资活动所得现金流量	16,186	28,722	14,317
投资活动所用现金流量净额	(177,466)	(399,962)	(150,649)
融资活动所得/(用)现金流量:			
非控股权益资本注资	-	392,000	-
提取银行贷款	347,707	248,768	8,116
发行股份所得收益	2,937,689	2,972	1,407
受限制货币资金减少/(增加)	136,524	-	(167,738)
偿还银行贷款	(239,086)	(62,171)	(85,565)
偿还租赁负债	(1,230)	(333)	(3,320)
已付利息	(3,803)	(1,552)	(52,720)
其他融资活动所用现金流量	(1,418)	-	(363)
融资活动所得/(用)现金流量净额	3,176,383	579,684	(300,183)
现金及现金等价物增加/(减少)净额	3,151,008	338,326	(289,642)
外汇汇率变动影响净额	(12,464)	(61,748)	(77,948)
期初现金及现金等价物	1,850,957	1,707,650	2,218,547
期末现金及现金等价物	4,989,501	1,984,228	1,850,957

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

张素心(董事长)

唐均君(总裁)

非执行董事

孙国栋

叶峻

独立非执行董事

张祖同

王桂坝太平绅士

叶龙蜚

承董事会命

华虹半导体有限公司

张素心

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二三年十一月九日